

TAZMO

タツモ株式会社 決算説明資料

2024年12月期第3四半期

2024年11月11日

証券コード 6266

INDEX

目次



1. 2024年12月期第3四半期 連結業績
2. セグメント情報
3. 市場（顧客）の状況
4. 補足資料



1

2024年12月期第3四半期 連結業績

売上高

24,739百万円

営業利益

4,601百万円

経常利益

4,524百万円

親会社株主に帰属
する当期純利益

3,094百万円

■ 概況

- 売上高は、装置の納入・立上計画の遅延により計画比で約15億円の未達となったものの、前年同期比では30%増となった。
- 売上高上昇に連動すると共に、研究開発費及び減価償却費等の減少や、販管費が想定より大幅に減少したことにより、利益が計画比で大きく上振れし前年同期比でも68.2%増となった。
- 市場の回復はスローであるが、アドバンスドパッケージ関連とパワーデバイスにおいて、引き合い増加の傾向がみられてきている。

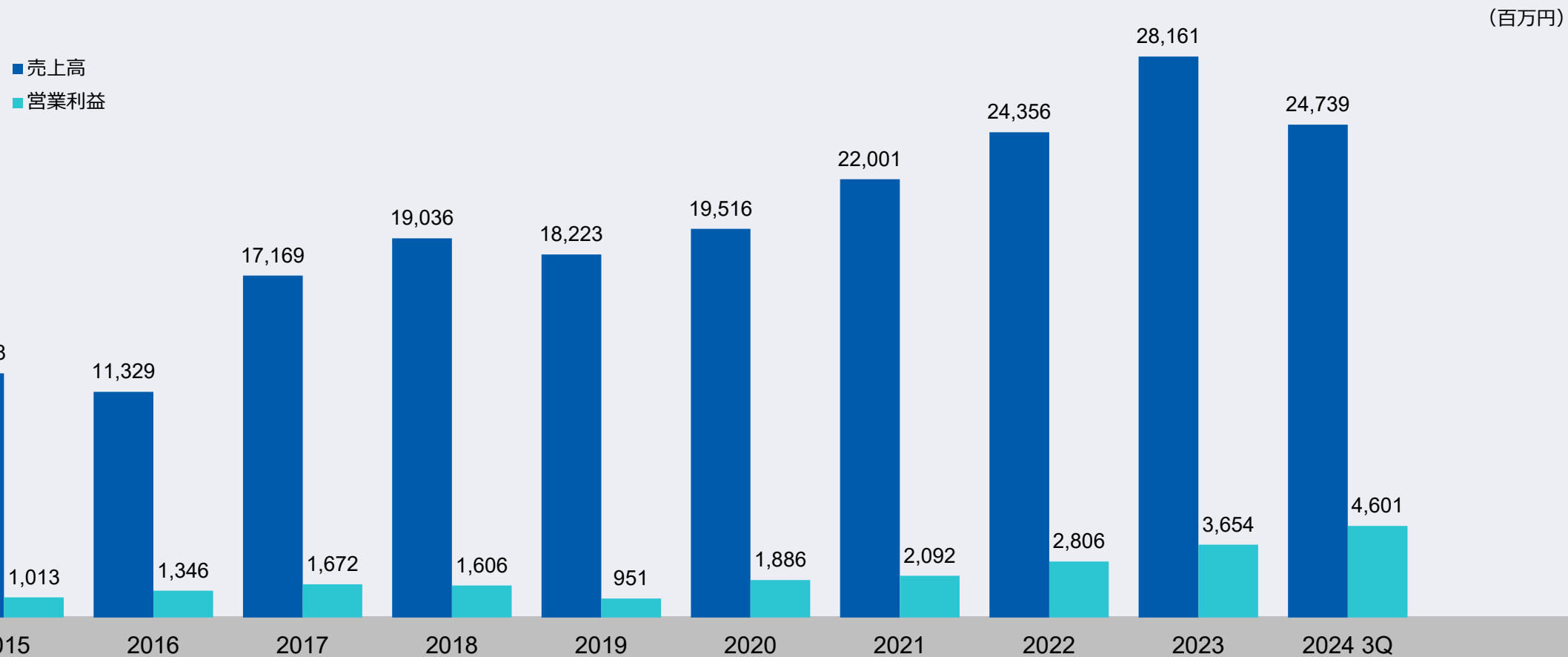
(百万円)	2023年12月期 Q3 実績	2024年12月期 Q3		前年同期比 増減率(%)	2024年12月期 計画	進捗率(%)
		実績	売上比(%)			
売上高	19,034	24,739	—	30.0	36,000	68.7
売上総利益	5,944	8,661	35.0	45.7	—	—
営業利益	2,405	4,601	18.6	91.3	4,600	100.0
経常利益	2,690	4,524	18.3	68.2	4,500	100.5
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,539	3,094	12.5	101.1	3,060	101.1

連結売上高・連結営業利益推移（四半期）

(百万円)

■ 売上高
■ 営業利益



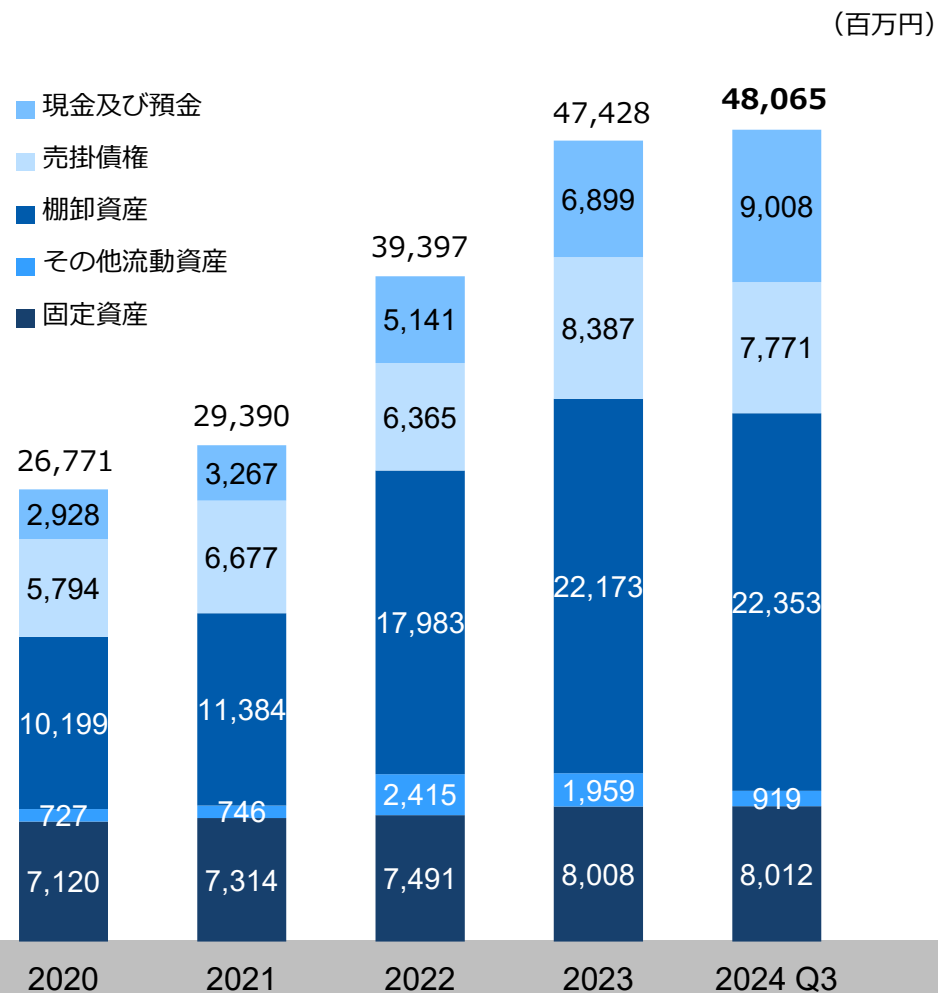


(百万円)	2023年12月期	2024年12月期 Q3	前期末比 増減率(%)
流動資産	39,420	40,053	1.6
固定資産	8,008	8,012	0.0
有形固定資産	7,007	7,001	0.0
無形固定資産	157	145	△7.6
投資その他資産	842	865	2.7
総資産合計	47,428	48,065	1.3
流動負債	21,380	17,654	△17.5
固定負債	5,952	7,405	24.4
負債合計	27,333	25,060	△8.3
純資産合計	20,095	23,005	14.5
自己資本比率	41.7%	47.1%	5.4P

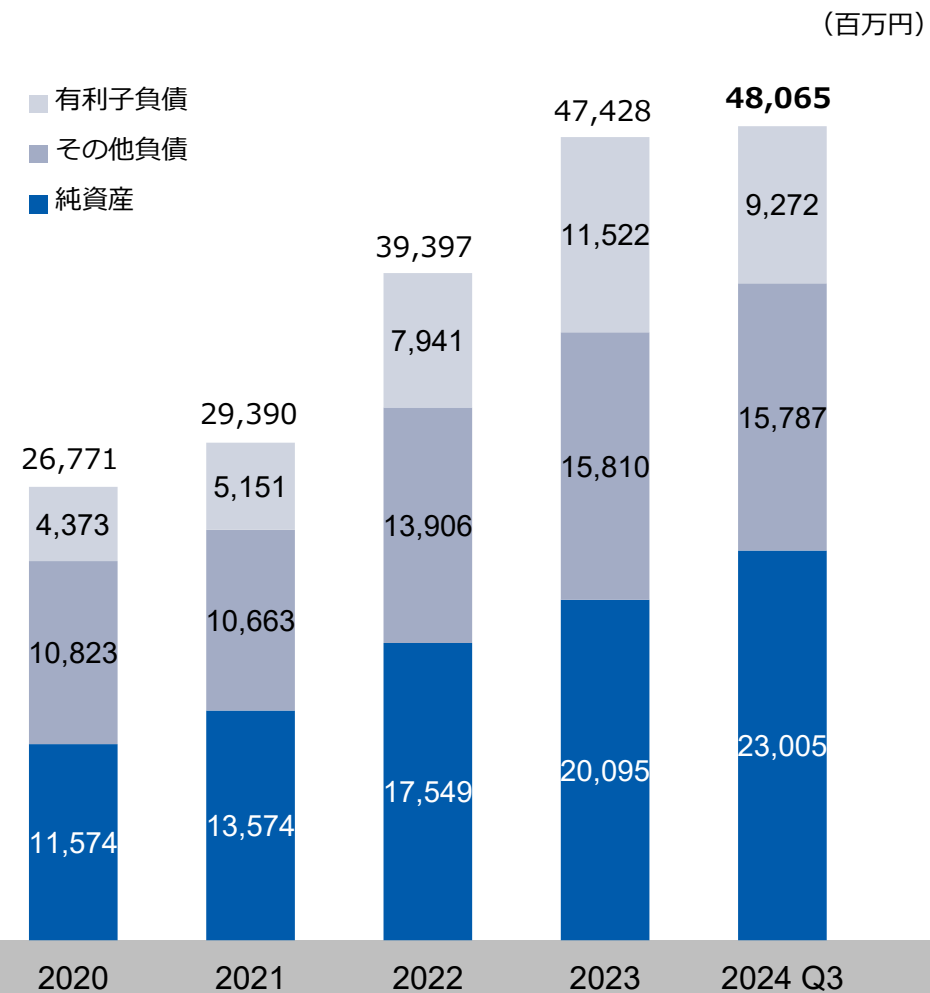
主な増減要因

流動資産	
現金及び預金	+ 2,108
受取手形及び売掛金	△1,405
流動負債	
短期借入金	△3,710
固定負債	
長期借入金	+1,448

資産



負債／純資産



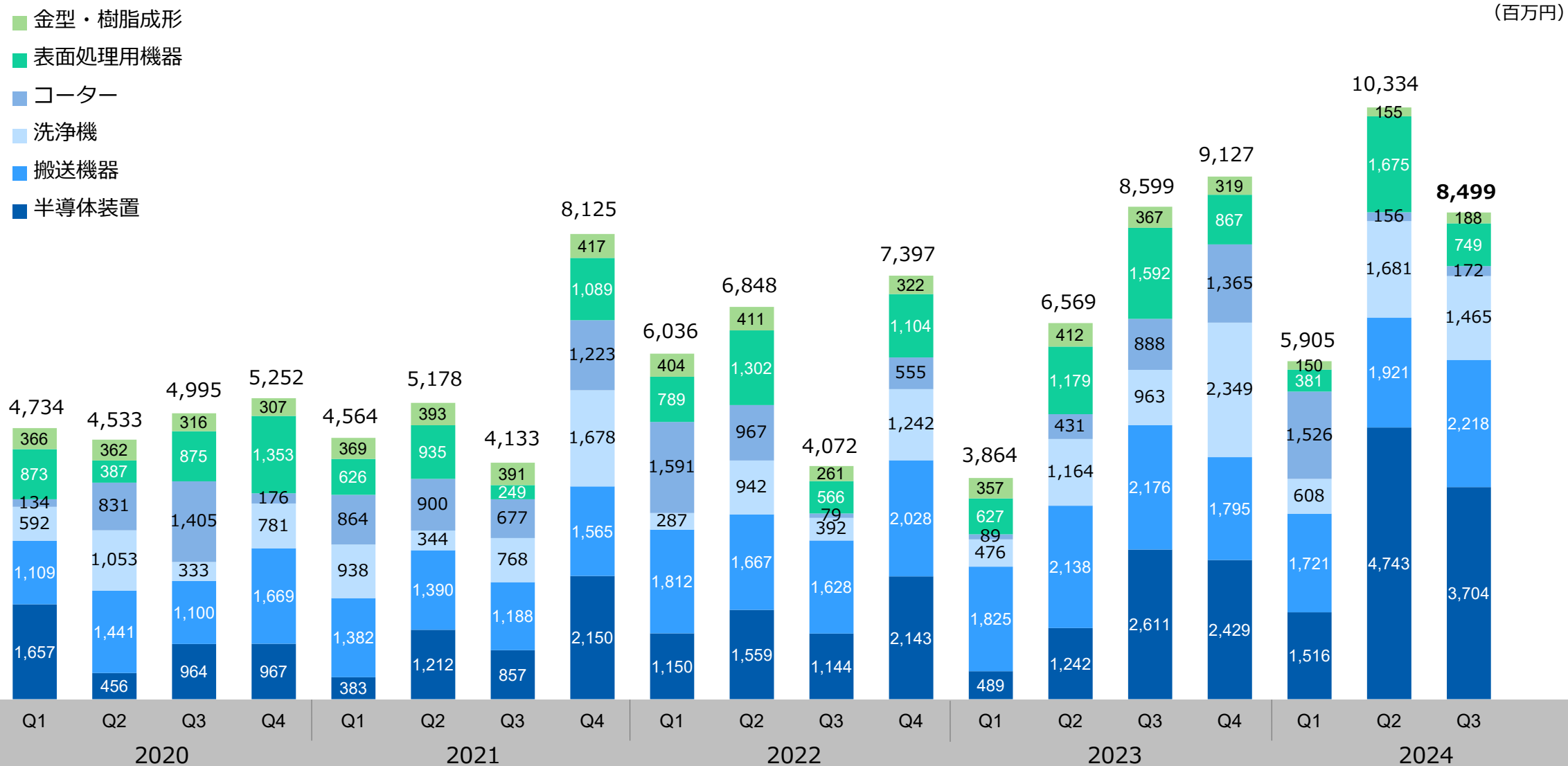


2

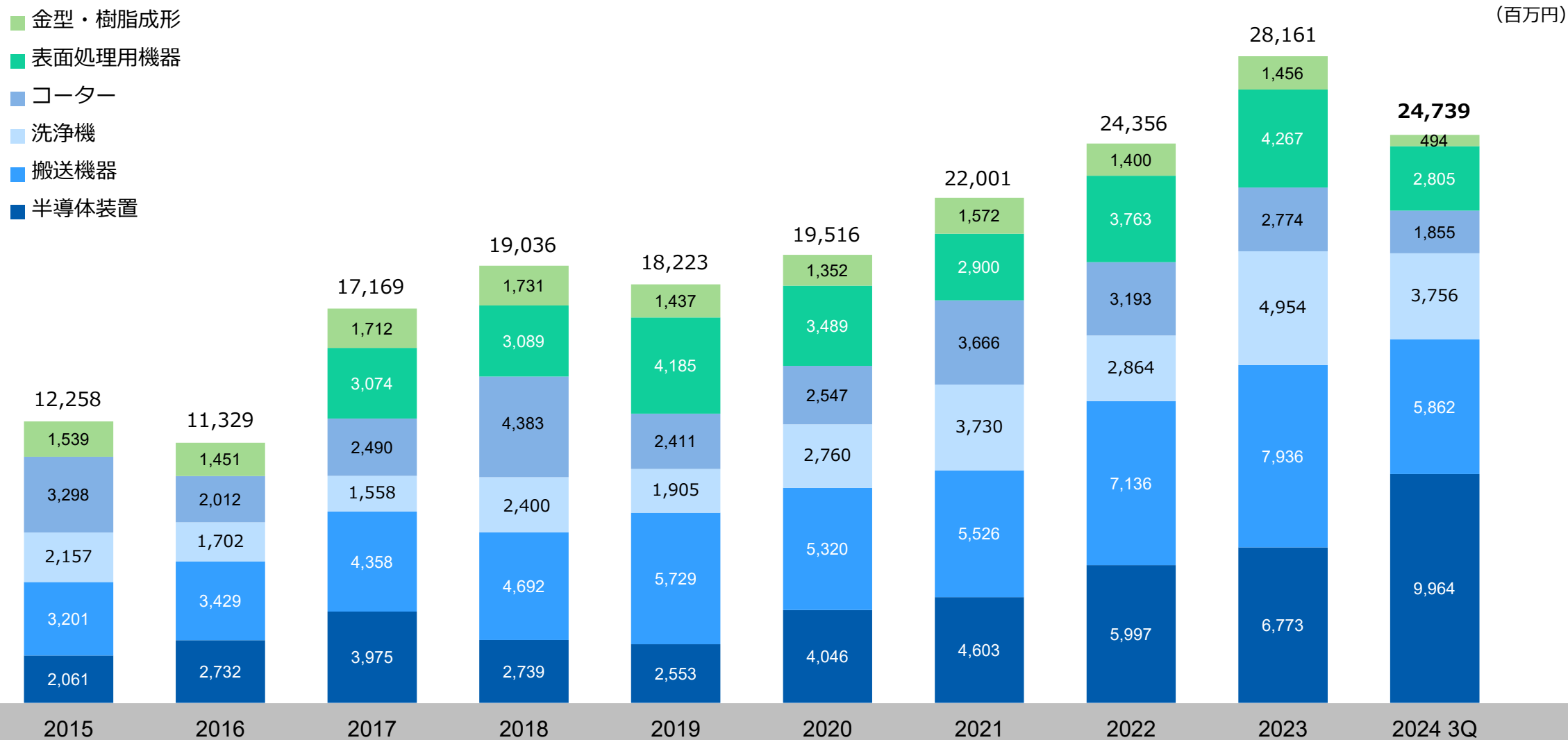
セグメント情報

		2023年12月期 Q3 実績	2024年12月期 Q3 実績	前期比 増減率(%)	2024年12月期 計画	進捗率(%)	
(百万円)							
プロセス機器事業	売上高	14,497	21,438	47.9	27,770	77.2	
	営業利益	2,333	4,491	92.5	4,250	105.7	
	■ 半導体装置	売上高	4,343	9,964	129.4	11,500	86.6
	■ 搬送機器	売上高	6,140	5,862	△4.5	8,100	72.4
	■ 洗浄機	売上高	2,604	3,756	44.2	5,800	64.8
	■ コーター	売上高	1,408	1,855	31.7	2,370	78.3
金型・樹脂成形事業	売上高	1,137	494	△56.6	1,700	29.1	
	営業利益	19	△217	—	30	—	
表面処理用機器事業	売上高	3,399	2,805	△17.5	6,530	43.0	
	営業利益	69	322	366.7	320	100.6	
セグメント間調整	営業利益	△17	5	—	—	—	
合計	売上高	19,034	24,739	30.0	36,000	68.7	
	営業利益	2,405	4,601	91.3	4,600	100.0	

セグメント別 売上高推移（四半期）

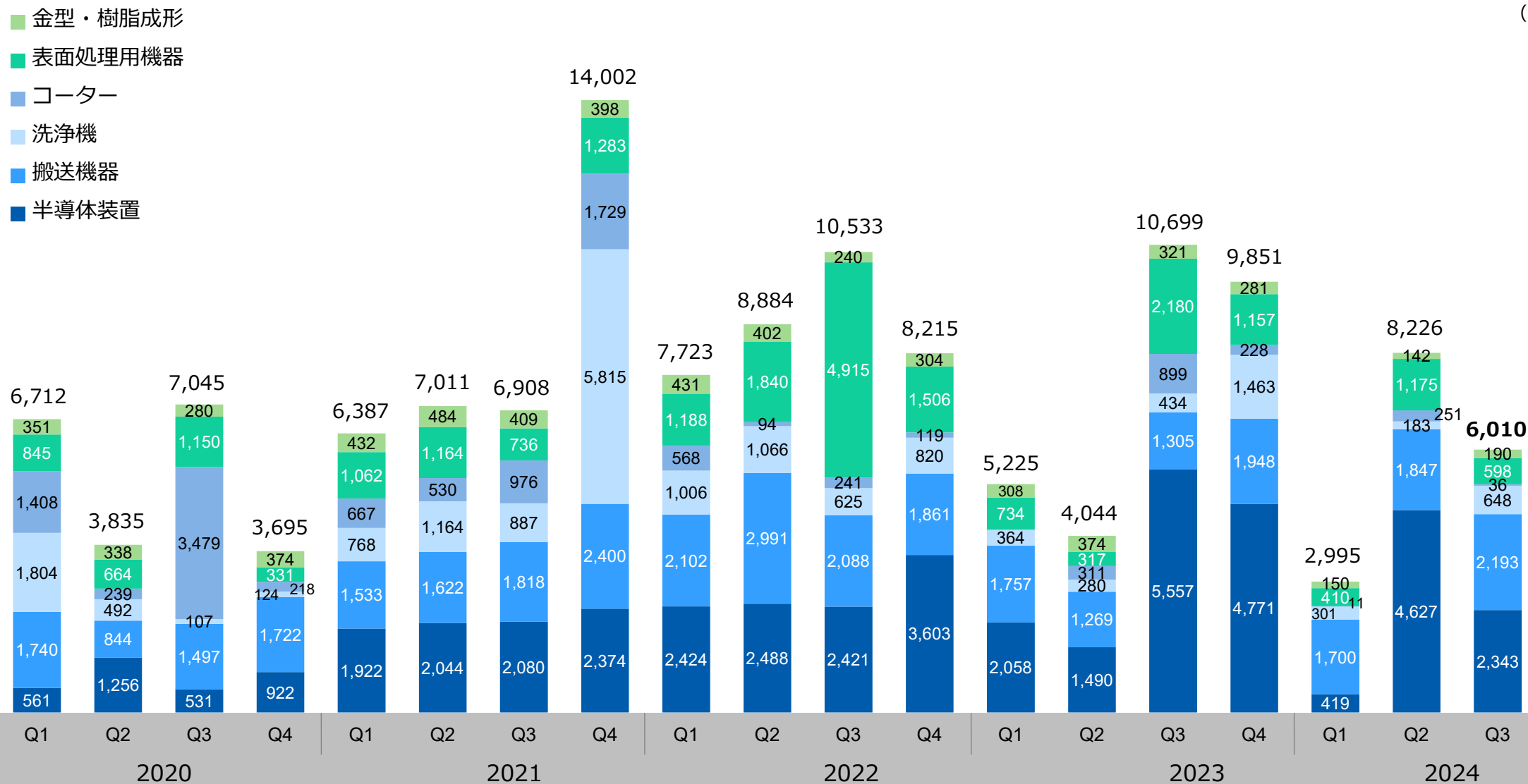


セグメント別 売上高推移（通期）

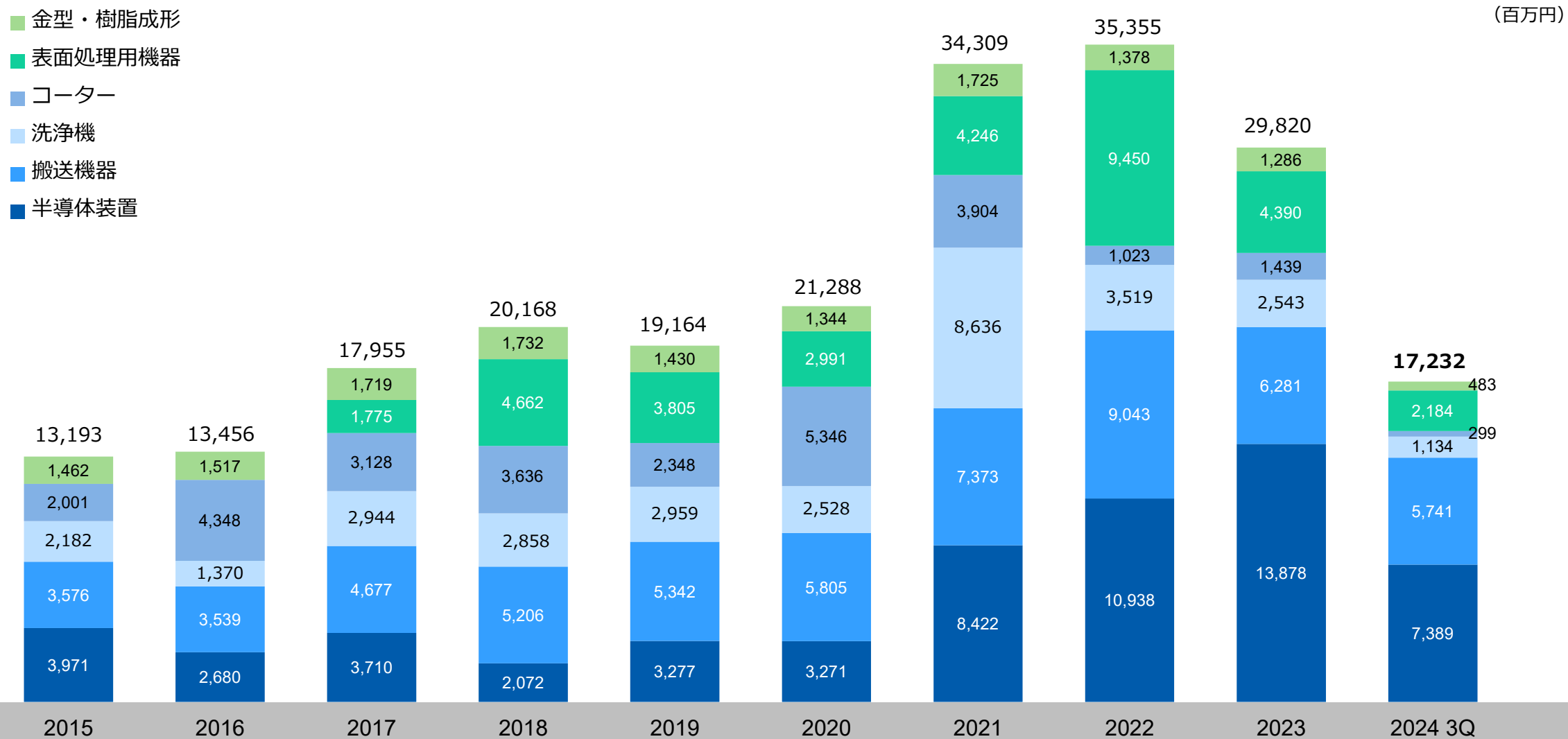


セグメント別 受注高推移（四半期）

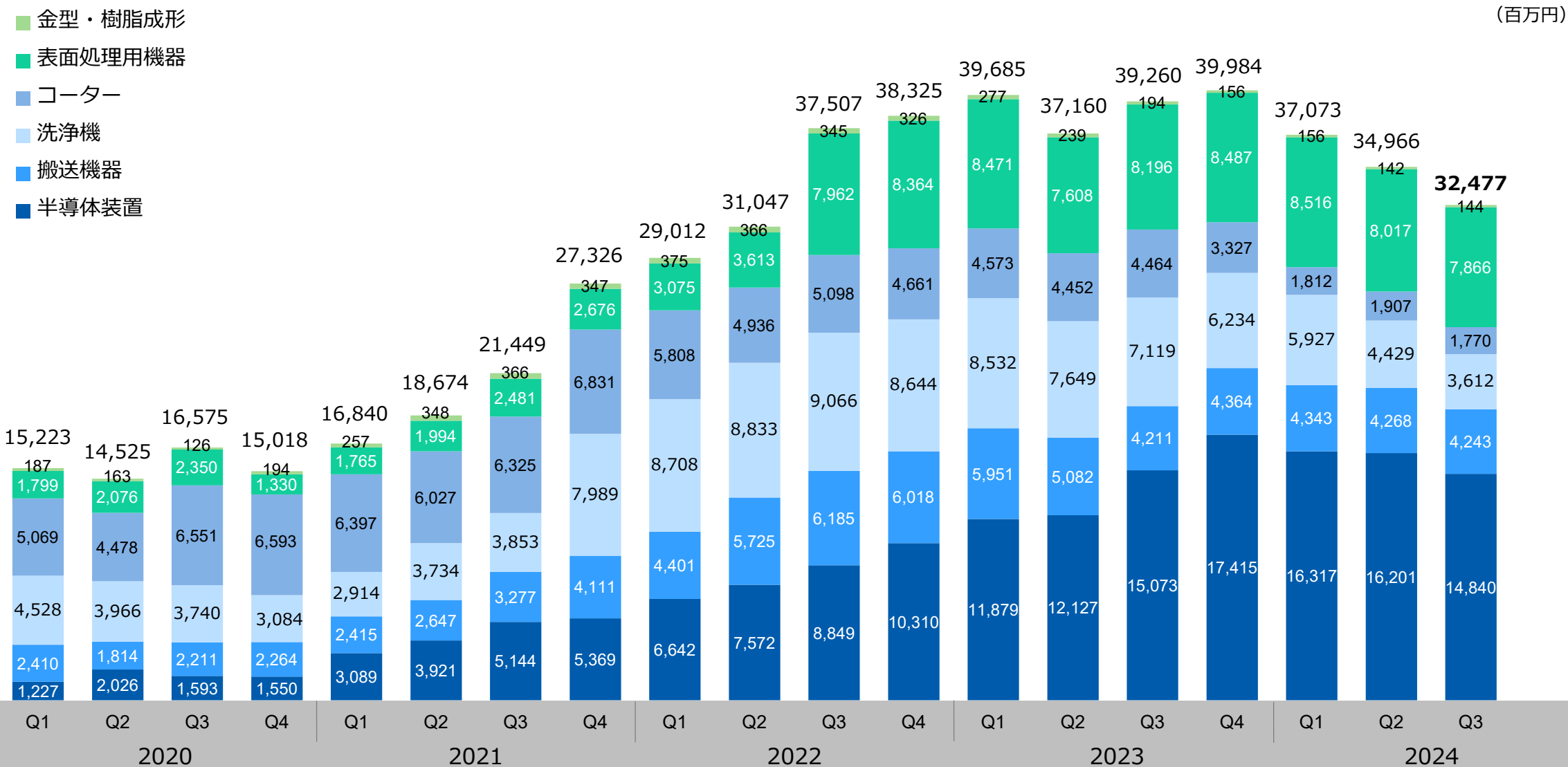
(百万円)



セグメント別 受注高推移（通期）



セグメント別 受注残高推移





3

市場（顧客）の状況

- 半導体製造装置では、アドバンスドパッケージ向け装置でまとまった受注があり今後も継続が見込まれる。更なる市場の拡大に期待している。パワー半導体向け装置は、出荷延期となった案件もあるが、少しずつ引合いが増えてきている。投資回復に備えていく。
- 搬送機器では、引き合いの回復にはもう少し時間がかかりそう。注力しているフレームを含む案件が増えてきており、受注額も増加している。
- スラリー供給装置の引合いが順調に推移しており、堅調に受注できている。洗浄装置でも新規案件の話が少しずつ出てきており、受注できるよう対応中。
- PLP装置の引合が増加しているが、R&D用や量産に向けてのものが中心。1件ずつ確実に受注できるよう営業・開発・プロセス評価に注力しつつ、今後の市場の拡大を期待している。
- 表面処理用機器では、めっき処理を含むウェット処理装置の案件は、以前よりも減少傾向にある。ウェット処理及び基板搬送装置共に、新規開発や新規引き合い案件に注力しながら受注拡大に向けて活動している。



4

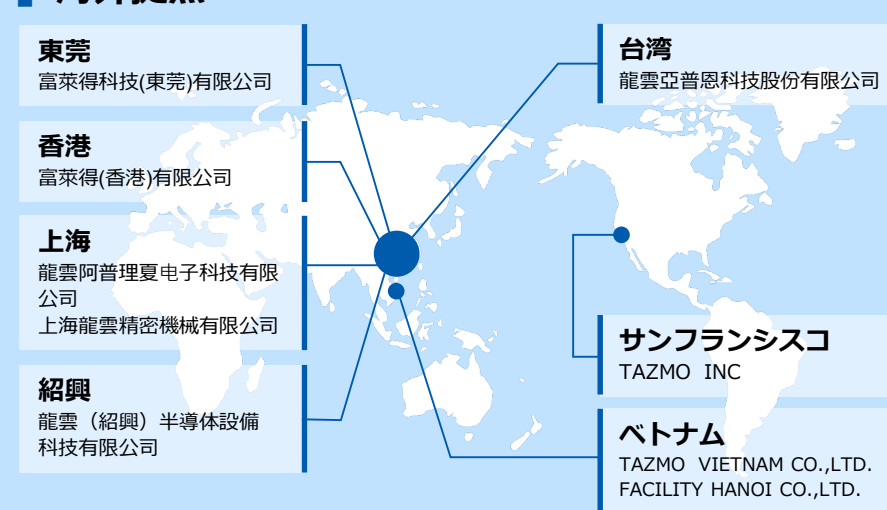
補足資料

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億6,859万682円
発行済株式数	14,842,354株
株主数	8,148名（2024年6月30日現在）
従業員数	単体 394名／連結 1,172名（2024年9月30日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 液晶製造装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、 精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

国内拠点・関連子会社



海外拠点



- | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|
| 1972 | ● | - 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立 | 2009 | ● | - 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結 |
| 1980 | ● | - インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始 | 2013 | ● | - アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築 |
| 1989 | ● | - 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始 | 2017 | ● | - 株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化 |
| 1990 | ● | - 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始 | 2018 | ● | - 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
| 1994 | ● | - エンボスキャリアテープの製造・販売を開始 | 2019 | ● | - 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転 |
| 1995 | ● | - インジェクション成形品の製造・販売を開始 | 2020 | ● | - アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併 |
| 2001 | ● | - 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始 | 2022 | ● | - 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立 |
| 2004 | ● | - JASDAQ市場に株式を上場 | | | |
| 2008 | ● | - TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立 | | | |

最先端の半導体やパッケージを製造する装置をはじめ、有機ELや液晶ディスプレイなどの製造装置、クリーン搬送ロボットなどを開発・製造・販売する事業を展開

半導体製造装置事業

半導体製造における塗布・現像・貼合・剥離など、各種プロセスに対応した装置を、40年に渡って培ったノウハウ・技術により、全世界に提供



搬送機器事業

半導体製造に欠かせないシリコンウェーハ等の搬送ロボットをはじめ、正確性・スピーディーさ・省スペースに対応した各種搬送システムを提供



洗浄装置事業

半導体製造の重要な工程であるシリコンウェーハ洗浄・スラリー供給装置や、廃液からリン酸を再生・再利用する装置を提供



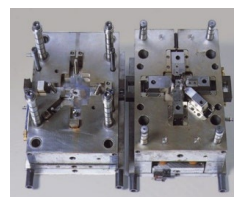
コーター事業

液晶ディスプレイ等、各種フラットパネル製造装置を提供。現在はPLP用装置やナノインプリント装置の開発を進めている。



金型・樹脂成形事業

部品製造に欠かせない金型技術は、創業時からのコア技術であり、ユーザー企業の様々なニーズに応える形で各種製品を提供



表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供

